

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260410

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	南方基金：张磊、冯飞、刘倩、宁双、汤冠豪、黎思思、孔晓欣，上证报：黄金滔、雷中校、覃秘等，共 22 名投资者及媒体人员
时间	2026 年 4 月 9 日下午 14:00~16:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待人员姓名	2026 年 4 月 9 日下午 14:00~16:30：总经理朱顺全先生、投资者关系总监熊亚威先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>公司介绍：</b></p> <p>公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、锂电业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。</p> <p><b>问 1：公司近期披露剥离通用打印耗材终端相关业务，请问本次战略调整的背景、主要目的及对公司未来发展的意义是什么？</b></p> <p><b>答：</b>本次出让珠海名图超俊、北海绩迅等子公司控股权、逐步退出通用打印耗材终端业务，是公司立足长期发展、聚焦核心赛道作出的重要战略安排。近年来，全球半导体产业国产替代加速，高端电子材料迎来历史性发展机遇，公司在半导体 CMP 抛光材料、光刻胶、显示材料等领域已形成技术领先、客户验证顺畅、产能持续释放的良好格局。为进一步集中资金、研发、人才、管理等核心资源，公司主动优化业务结构，逐步退出竞争激烈、附加值相对有限的通用打印耗材终端制造环节。本次交易完成后，公司可回笼大额现金资源，优化资产负债结构，降低经营复杂度，将全部精力聚焦于半导体关键材料主业，进一步强化在高端制程、核心品类上的研发投入与产能扩</p>

张，持续提升公司核心竞争力与盈利质量，推动公司从传统打印耗材企业向全球一流半导体材料平台型企业转型，为股东创造更可持续、更高质量的长期价值。

**问 2：公司高端晶圆光刻胶是市场高度关注的业务方向，目前 KrF、ArF 光刻胶项目建设、产能释放、客户验证及批量供货情况如何？**

**答：**公司高度重视高端光刻胶业务布局，已建成国内领先的 KrF 及 ArF 光刻胶规模化量产产线，实现从关键原材料、树脂合成到配方工艺、量产制造的全流程自主制备，有效打破海外厂商长期垄断格局。目前，3 款产品（含 KrF、ArF 品类）已实现稳定批量供货，成功导入国内主流晶圆厂供应链；超 12 款产品进入加仑样测试阶段，验证进度持续推进。公司产品性能、稳定性、一致性均达到国际同类产品水平，获得客户端高度认可。公司持续加大光刻胶研发投入，不断优化产品性能、良率及稳定性，匹配客户不同工艺节点需求。同时，公司根据市场需求节奏有序释放产能，保障供货能力，未来将持续深化与头部晶圆厂的合作，加快高端光刻胶产品的全面导入与规模化销售，进一步提升高端晶圆光刻胶市场份额。

**问 3：公司在研发创新方面持续投入，目前核心技术壁垒、研发团队及专利布局情况如何，如何保持长期技术领先优势？**

**答：**公司始终坚持技术创新驱动发展战略，持续高强度投入半导体和锂电关键材料研发，已构建起覆盖核心配方、合成工艺、量产装备、质量控制等全链条的自主知识产权体系。公司拥有经验丰富的专业研发团队，在材料分子设计、纳米分散技术、高分子合成、制程工艺等方面积累了大量核心技术。同时，公司作为国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业及制造业单项冠军企业，拥有多项发明专利，覆盖 CMP 抛光材料、高端晶圆光刻胶、显示材料等核心领域，形成严密的技术保护壁垒。为保持技术领先性，公司将坚持前瞻布局与市场需求相结合，持续加大对全制程材料、新型电子材料和锂电材料的研发投入；深化产学研合作，加快关键技术攻关与成果转化；完善研发激励机制，吸引和培养高端技术人才，确保公司核心技术始终紧跟行业前沿，持续巩固并扩大在中国半导体材料领域的领先地位。

**问 4：本次业务调整完成后，公司未来整体发展战略、产业布局方向及重点投资领域有哪些规划？**

**答：**剥离通用打印耗材终端业务后，公司将更加坚定地实施“聚焦半导体关键材料，打造全球一流高端电子材料平台”的总体发展战略。未来公司将以半导体 CMP 抛光材料、OLED 显示材料和高端晶圆光刻胶为核心增长极，持续做强半导体显示材料业务，积极培育布局新型锂电材料等前沿赛道，形成多品类协同、高附加值驱动的业务格局。在投资布局上，公司将重点围绕核心主业，加大对高端晶圆光刻胶、CMP 抛光垫、高端抛光液及配套材料的产能建设投入；持续完善上游关键原材料自主配套能力，提升供应链安全与成本优势；积极拓展海内外市场，深化与头部客户的战略合作。公司将坚持“技术自主、产业自主、供应链自主”的发展原则，通过规模化、平台化、国际化发展，不断提升综合竞争力，力争成为全球半导体材料领域具有重要影响力的供应商。

	<p><b>问 5：公司在产能建设与供应链保障方面有哪些安排，如何应对下游客户快速增长的需求，确保产品稳定供应？</b></p> <p><b>答：</b>公司高度重视产能建设与供应链安全保障，始终坚持以市场需求为导向，科学规划产能扩张节奏。一方面，公司持续推进现有生产基地技改扩产，优化生产工艺，提升生产效率与产品良率，快速释放现有产能；另一方面，有序推进新建项目建设，扩大 CMP 抛光材料、高端晶圆光刻胶、半导体显示材料等核心产品的规模化生产能力，匹配下游客户持续增长的需求。在供应链管理方面，公司持续推进核心原材料自主制备与多元化供应体系建设，提升供应链韧性；通过长期战略合作、战略储备等方式，保障核心原材料稳定供应；同时建立完善的生产计划与库存管理体系，强化质量管控，确保产品交付及时、质量稳定。公司将持续提升供应链管理水平与柔性生产能力，为下游客户提供可靠、高效、稳定的材料供应保障。</p> <p><b>问 6：公司 CMP 抛光材料业务目前国内市场地位如何，抛光垫、抛光液及相关配套材料的布局、产能规划及未来增长空间是怎样的？</b></p> <p><b>答：</b>公司是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的 CMP 抛光垫供应商，也是国内少数同时布局抛光垫、抛光液、清洗液等关键材料并实现协同发展的供应商，在国内半导体 CMP 材料领域占据领先地位，供应比例持续提升。公司 CMP 抛光垫产品已全面进入国内主流晶圆厂，覆盖逻辑、存储等多种制程，产品稳定性、一致性获得客户高度认可。抛光液业务依托公司在材料配方、纳米分散等核心技术快速突破，与抛光垫形成协同销售优势，市场拓展顺利。在产能方面，公司根据下游需求持续优化产能布局，推进新建产能建设与现有产能技改，不断提升供应能力。未来，随着国内晶圆厂产能持续扩张、制程节点持续演进，以及第三代半导体、大尺寸硅片等新应用场景不断涌现，CMP 材料市场空间持续扩大，公司将凭借技术壁垒、客户壁垒、全产品线布局优势，实现 CMP 业务持续稳健增长。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 4 月 9 日